

# 长鑫科技（CXMT）科创板 IPO 招股说明书精华摘要

长鑫科技集团股份有限公司 · 上交所科创板（2025-12-30 受理，科创板预先审阅机制首单） · 摘要日期：2026-07-26

## 发行概况

- 拟发行 ≤106.22 亿股（超额配售前），占发行后总股本 ≥10%
- 拟募资 **295 亿元**：75 亿晶圆产线技改 + 130 亿 DRAM 技术升级 + 90 亿前瞻研发
- 上市标准：科创板第四套（预计市值 ≥30 亿 + 年营收 ≥3 亿）
- 保荐：中金公司 + 中信建投；审计：德勤
- 无控股股东、无实际控制人

## 公司定位

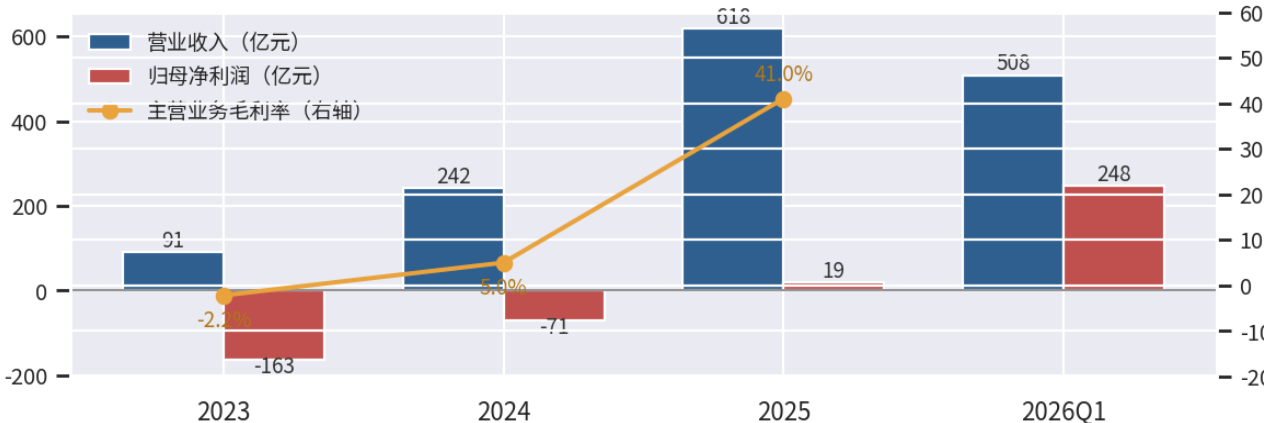
- 中国规模最大、布局最全的 DRAM IDM 企业，合肥/北京 3 座 12 英寸晶圆厂
- Omdia：产能、出货量、销售额均为**中国第一、全球第四**；2025Q4 全球销售份额 **7.67%**
- 产品覆盖 DDR4/DDR5、LPDDR4X/LPDDR5/5X（晶圆/芯片/模组）
- 客户：阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、荣耀、OPPO、vivo 等
- 2025 年产能利用率 95.73%；专利境内 3,929 件 + 境外 3,043 件

## 核心财务数据（单位：亿元人民币）

| 项目         | 2023          | 2024          | 2025          | 2026Q1         | 2026H1E     |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 营业收入       | 90.87         | 241.78        | 617.99        | 508.00 (+719%) | 1,100–1,200 |
| 归母净利润      | -163.40       | -71.45        | 18.75（扭亏）     | 247.62         | 500–570     |
| 主营业务毛利率    | -2.19%        | 5.00%         | 41.02%        | —              | —           |
| 研发投入（占营收比） | 46.70 / 51.4% | 63.41 / 26.2% | 95.93 / 15.5% | —              | —           |
| 经营现金流净额    | -72.72        | 68.97         | 365.20        | 425.66         | —           |

注：2023–2025 年营收复合增速 160.78%；2026Q1 数据经德勤审阅，2026H1 预告未经审计/审阅。截至 2025 年末总资产 3,367.85 亿元，合并资产负债率 54.24%。

### 业绩爆发：2025 年扭亏为盈，2026Q1 单季归母净利 247.6 亿元



## 主要股东（发行前）

- 清辉集电 21.67%（第一大股东）
- 大基金二期 9.80%、合肥集鑫（员工持股）8.37%、安徽省投 8.88%
- 阿里、腾讯、小米产投、兆易创新（0.95%，董事长朱一明任其董事长）、人保、国调基金、君联资本等

## 核心风险提示

- 累计未弥补亏损 **-366.5 亿元**，短期内无法现金分红
- DRAM 强周期：2024/2025 年产品均价 +55%/+34%，行业转弱将直接冲击业绩
- 固定资产 1,830 亿元（占总资产 54%），折旧压力大
- 前五大客户收入占比约 68%，集中度偏高
- 技术与三星/海力士/美光仍有差距；研发、人才与知识产权风险

资料来源：长鑫科技集团股份有限公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（上交所披露，报告期 2023–2025 年度）；Omdia。本摘要仅供研究参考，不构成投资建议。